

2019年2月6日

スマートフォン向けスペーサーテープの本格生産開始について

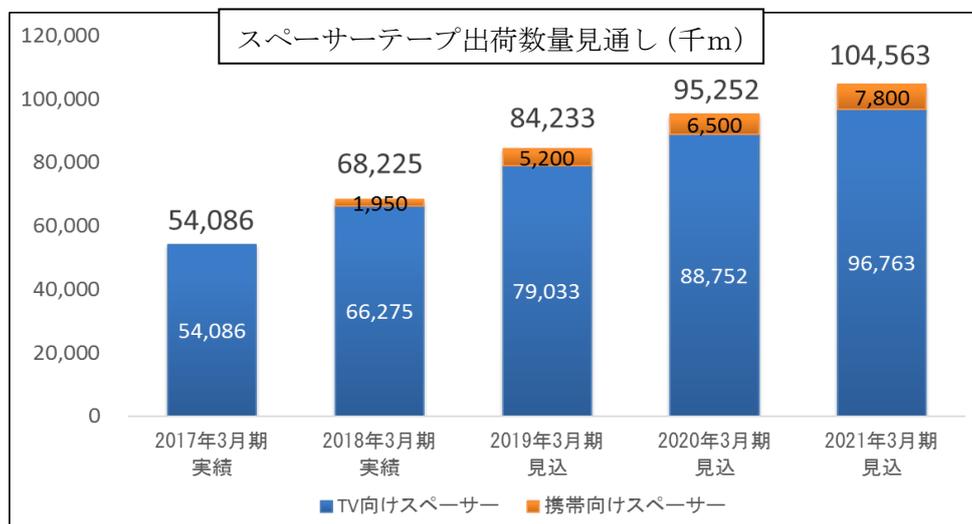
世界市場でのスマートフォンの出荷台数は年間で推定約15億台と言われております。そのうち弊社顧客製品であるTAB(COF)*が搭載されているスマートフォンの比率が急拡大しております。

2018年3月期のCOFを使用したスマートフォンの搭載台数は1.5億台に到達し、約10%の占有率となります。2019年3月期においても約4億台(26%)に大きく伸張する見込みです。これはTAB(COF)を搭載することでディスプレイの高精細化が実現可能なことが要因と考えられます。

現在、当社スマートフォン向けスペーサーテープは世界最大の中国市場へ納入が開始され、当社半導体資材事業の2期連続の2桁成長(23%:数量ベース)を牽引しています。本スペーサーテープは2019年3月期で売上数量の約6.1%の占有率となる見込みです。

当社はこれまで、現在4割近くに拡大した4Kテレビ(当社スペーサーテープを従来比2.6倍使用)の比率拡大に合わせ、生産増強を繰り返して参りましたが、今後はスマートフォン向けスペーサーテープの旺盛な需要を視野に入れ、2020年3月期の生産体制を現在の月産750万mから1000万m体制に増強すべく、日韓両拠点の生産再編を実施して参ります。

※TAB(タブ)とは、「Tape Automated Bonding」の略称で、半導体(ドライバーIC)とフィルム状のフレキシブル回路基盤を自動で実装していく技術のことを指し、COF(Chip on film)はTAB技術における一つの方式を意味します。



以上